

СОГЛАСОВАНО

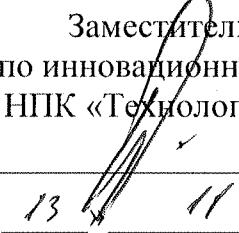
УТВЕРЖДАЮ

Старший инженер 512 ВП МО РФ

  
А.Р. Чириченко

« 13 » 11 2019г.

Заместитель директора  
по инновационной деятельности  
НПК «Технологический центр»

  
В.Г. Сницар

« 13 » 11 2019г.

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

5529TP015

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

ГАВЛ.431268.022Д1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14449	 А.Н. Денисов			

Главный конструктор изделия

  
А.Н. Денисов

« 13 » 11 2019г.

НАЗНАЧЕНИЕ, СХЕМО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ,  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Перв. примен.

ГАВЛ.431268.022

Справ. №

Микросхемы интегральные 5529TP015 представляют собой многофункциональные цифровые матрицы, выполненные по полупроводниковой технологии на МОП-транзисторах.

Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Количество элементов в схеме электрической (количество эквивалентных вентилей), не менее - 156 000 (39 000).

Конструктивное исполнение для микросхемы 5529TP015 в корпусе МК 5123.28-1.01 приведено на рисунке 1.

Схема электрическая структурная микросхемы представлена на рисунке 2. Схема электрическая структурная периферийной ячейки приведена на рисунке 3.

Электрические параметры микросхемы приведены в таблице 1. Предельные и предельно-допустимые значения электрических режимов эксплуатации микросхемы приведены в таблице 2.

Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

– микросхема 5529TP015-X<sup>1)</sup> – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус  
МК 5123.28-1.01, карта заказа<sup>2)</sup>;

<sup>1)</sup> X – Регистрационные номера карт заказа (цифровые или буквенно-цифровые коды), указанные в обозначении полузаизных микросхем на основе БК в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

<sup>2)</sup> Децимальные номера карт заказа в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

Подп. и дата  
*Григорьев*

Инв. № подп.  
*11449*

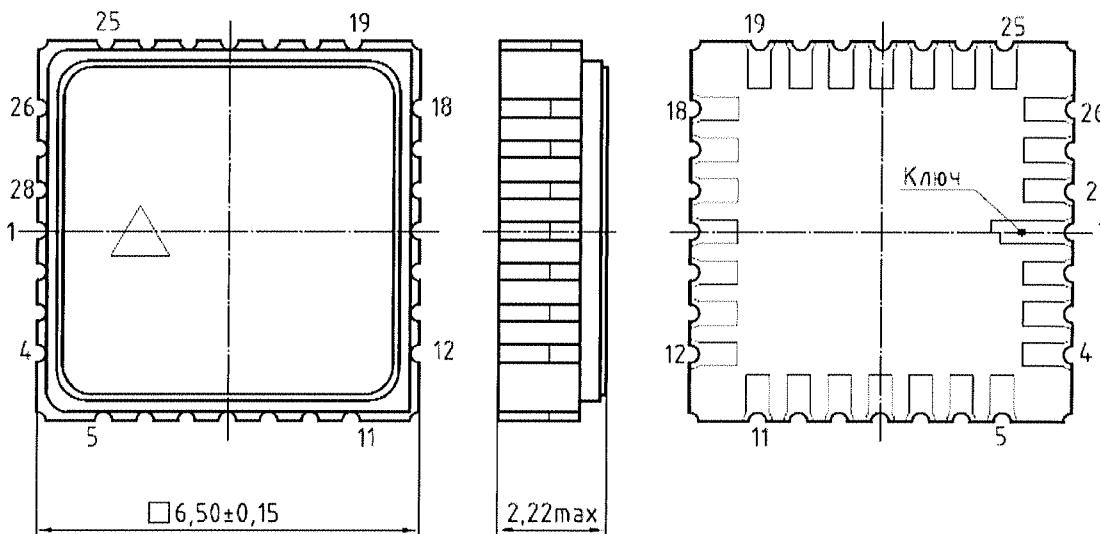
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Астахова	<i>АС</i>	<i>13.11.19</i>	
Пров.	Тикашкин	<i>Т</i>	<i>13.11.19</i>	
Н. контр.	Казаков	<i>А.К.</i>	<i>13.11.19</i>	
Утв.	Денисов	<i>Д</i>	<i>13.11.19</i>	

ГАВЛ.431268.022Д1  
Микросхема интегральная  
5529TP015  
Справочный лист

Лит.      Лист      Листов

A      2      27

## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником ( $\Delta$ ). Первый вывод микросхем обозначен ключом, который находится на стороне корпуса, противоположной крышке (вид снизу), и является самым длинным выводом из всех выводов. Нумерация выводов на виде снизу – по часовой стрелке. Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 1 – Микросхема интегральная 5529TP015

Корпус МК 5123.28-1.01

Металлокерамический

Материал покрытия выводов: золото

Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.022ЭТ.

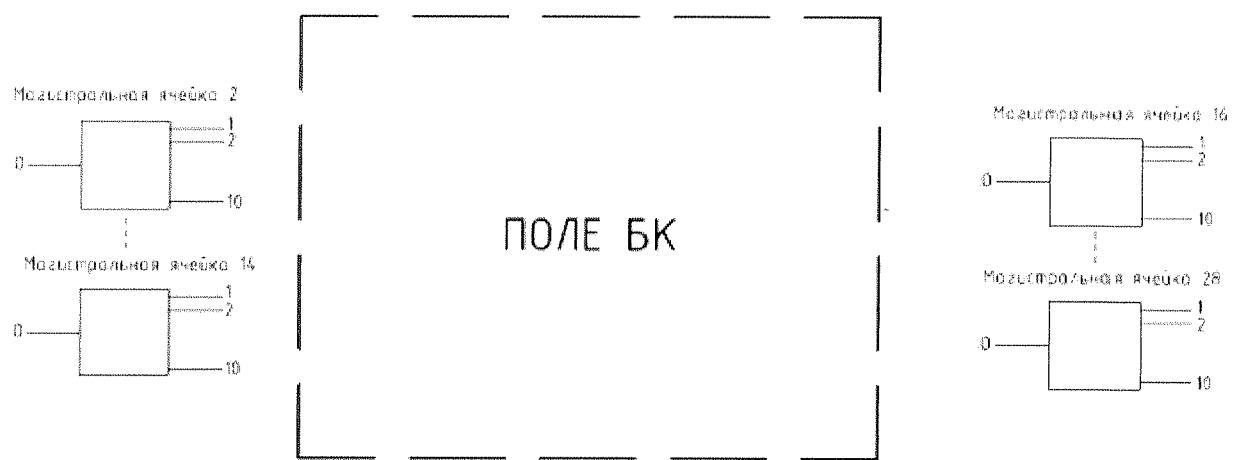
Масса микросхемы не должна превышать 0,5 г

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1449	26.07.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

ГАВЛ.431268.022Д1

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



1. Нумерация выводов ячеек приведена условно. Обозначения выводов приведены в соответствующей регистрационному номеру карте заказа.
2. Нумерация ячеек поля соответствует номеру столбца ячеек в поле микросхемы и порядковому номеру в столбце.
3. Магистральная ячейка 15 (на схеме не показана) соответствует контакту «Земля».
4. Магистральная ячейка 1 (на схеме не показана) соответствует контакту «Питание»

Рисунок 2 - Схема электрическая структурная микросхемы 5529TP015

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
12447	Лист № 16. С.И.ШИ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						4

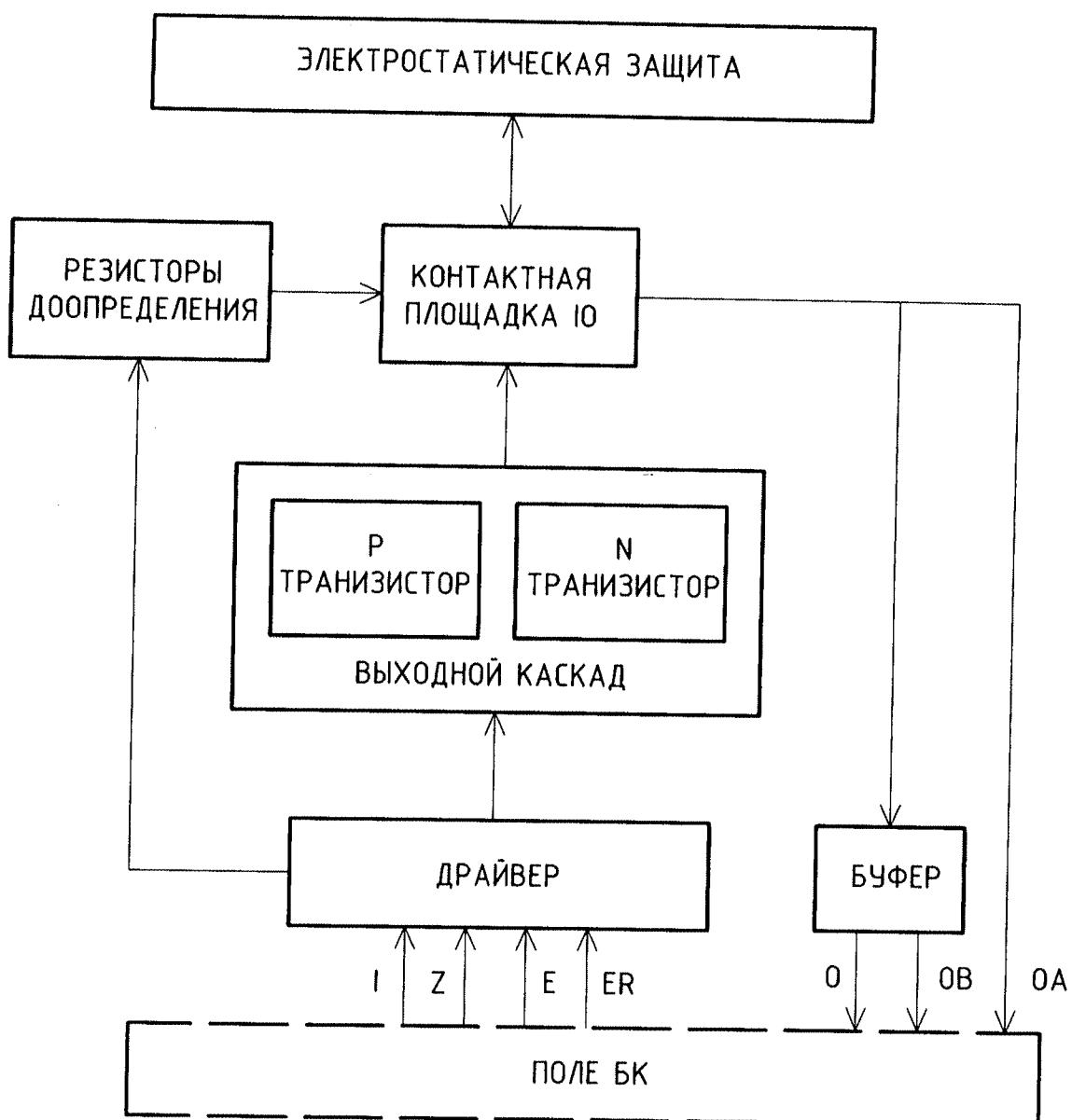


Рисунок 3 – Схема электрическая структурная периферийной ячейки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17747	Жуков. И. В. 26.01.2017			

Лист

5

# ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Механические факторы

### 1 Синусоидальная вибрация

Диапазон частот, Гц 1 – 5000

Амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g) 400 (40)

### 2 Удары одиночного действия в любом направлении

Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с<sup>2</sup> (g) 15000 (1500)

Длительность действия ударного ускорения, мс 0,1 – 2,0

### 3 Удары многократного действия в любом направлении

Амплитуда пикового ударного ускорения, мс (g) 1500 (150)

Длительность действия ударного ускорения, мс 1–5

### 4 Линейное ускорение в любом направлении

Амплитуда линейного ускорения, м/с<sup>2</sup> (g) 5000 (500)

### 5 Акустический шум

Диапазон частот, Гц 50 – 10000

Уровень звукового давления

(относительно 0,00002 Па), дБ 170

## Климатические факторы

### 1 Атмосферное пониженное рабочее давление, Па

(мм рт. ст.)  $1,3 \times 10^{-4} (10^{-6})$

### 2 Повышенное рабочее давление, кПа(мм рт. ст.)

294(2205)

### 3 Повышенная температура среды:

рабочая, °C +85

предельная, °C +125

### 4 Пониженная температура среды:

рабочая, °C минус 60

предельная, °C минус 60

### 5 Смена температур:

от пониженной предельной минус 60

температуры среды, °C

до повышенной предельной минус 60

температуры среды, °C +125

### 6 Повышенная относительная

влажность при 35°C, % 98\*

Вид исполнения по ГОСТ РВ 20.39.414.1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
177449	Дир. Н.Н. Ильин			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						6

7 Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней)	*
8 Соляной (морской) туман	*
9 Плесневые грибы	
10 Статическая пыль	**
11 Контрольные среды (среды заполнения), объемная доля компонентов контрольной среды, %	
гелиево-воздушная	90
аргоно- воздушная	90
аргоно- азотная	90

\*Соответствие микросхем данному требованию обеспечивается при условии их многослойного лакового покрытия в составе аппаратуры.

\*\*Требования по устойчивости к воздействию статической пыли не предъявляются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГУЧО	Дир. № 01.02.01			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	GAVL.431268.022Д1	Лист
						7

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания  $U_{CC}$  микросхем должно быть от 2,70 В до 3,63 В.

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды <sup>1)</sup> , С
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, $I_{OL}$ от 1 до 12,0 мА	$U_{OL}$	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, $I_{OH}$ от 1 до 12,0 мА	$U_{OH}$	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{CC}$	-	10,0 <sup>2)</sup> 30,0 <sup>2)</sup>	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на входе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{ILL}, I_{ILH}$	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{IOZH})=U_{CC}$ , $U_{OZL}(U_{IOZL})=0$ В	$I_{OZL}, I_{OZH}$	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{RL}$	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{RH}$	0,005	2,0	+25±10 -60 +85

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
14749	Лист № 01.01			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						8

*Окончание таблицы 1*

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды <sup>1)</sup> , С
		не менее	не более	
8 Время задержки на вентиль <sup>3)</sup> , пс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	$t_{DB}$	-	60,0	+25±10
			100,0	-60
				+85
9 Входная ёмкость, пФ	$C_I$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
10 Выходная ёмкость, пФ	$C_O$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85

<sup>1)</sup> Погрешность задания температуры составляет ± 3 °С.

<sup>2)</sup> Значения могут быть уточнены в карте заказа.

<sup>3)</sup> В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1 Напряжение питания, В	$U_{CC}$	2,7	3,63	-0,4	4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	$U_{OZ}$	0,0	$U_{CC}$	-0,4	$U_{CC}+0,4$ , но не более 4,0
3 Входное напряжение низкого уровня, В	$U_{IL}$	0,0	0,4 <sup>1)</sup>	-0,4	-
4 Входное напряжение высокого уровня, В	$U_{IH}$	( $U_{CC}-0,4$ )	$U_{CC}$	-	$U_{CC}+0,4$ , но не более 4,0

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
11449	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						9

*Окончание таблицы 2*

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I <sub>OL</sub>	-	12,0	-	24,0
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I <sub>OH</sub>	-	12,0	-	24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C <sub>L</sub>	-	150,0	-	250,0

### НАДЕЖНОСТЬ

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕНВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более  $(65 + 5)^\circ\text{C}$  и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при  $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5\%$ , выходные токи  $I_{OL}$ ,  $I_{OH}$  не более 50 % от предельно-допустимых значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости ( $T_{Cs\gamma}$ ) микросхем при  $\gamma = 99\%$  при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы  $T_{sl}$ , устанавливаемого численно равным  $T_{Cs\gamma}$ .

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. №	Инв. №	Взам. инв. №
17779	26.07.2010			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						10

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы должен быть следующим:

- при включении на микросхемы сначала подается напряжение питания  $U_{CC}$ , а затем входные напряжения  $U_I$ , или одновременно;
- при выключении напряжение питания  $U_{CC}$  снимается последним или одновременно с входными напряжениями  $U_I$ .

Допускается работа микросхем при ёмкости нагрузки  $C_L$  до 250 пФ. При этом динамические параметры не гарантируются.

Неиспользуемые выводы микросхем допускается подключать к шине общего вывода GND (0 В) или к шине напряжения питания  $U_{CC}$ .

Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в картах заказа.

Нумерацию, обозначение, наименование выводов, дополнительные указания к этапу разработки аппаратуры приводят в картах заказа.

Рекомендуется установку и крепление микросхем на платы проводить в соответствии с рисунком 4.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется лак УР-231 по ТУ 6-21-14 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 в 3 слоя.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов  $V_{CC}$  и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

В непосредственной близости между выводами  $V_{CC}$  и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
14449	27.06.04			

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						11

емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры.

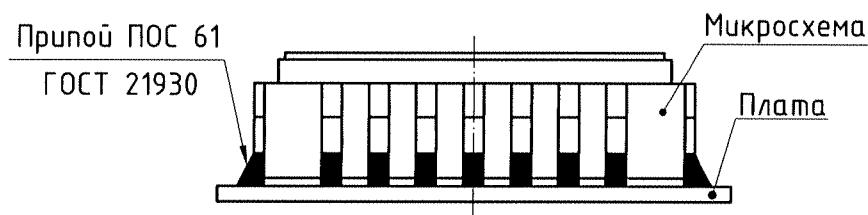


Рисунок 4 – Пример установки микросхем 5529TP015 на плате

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
12345	Зиц 16.01.20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						12

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

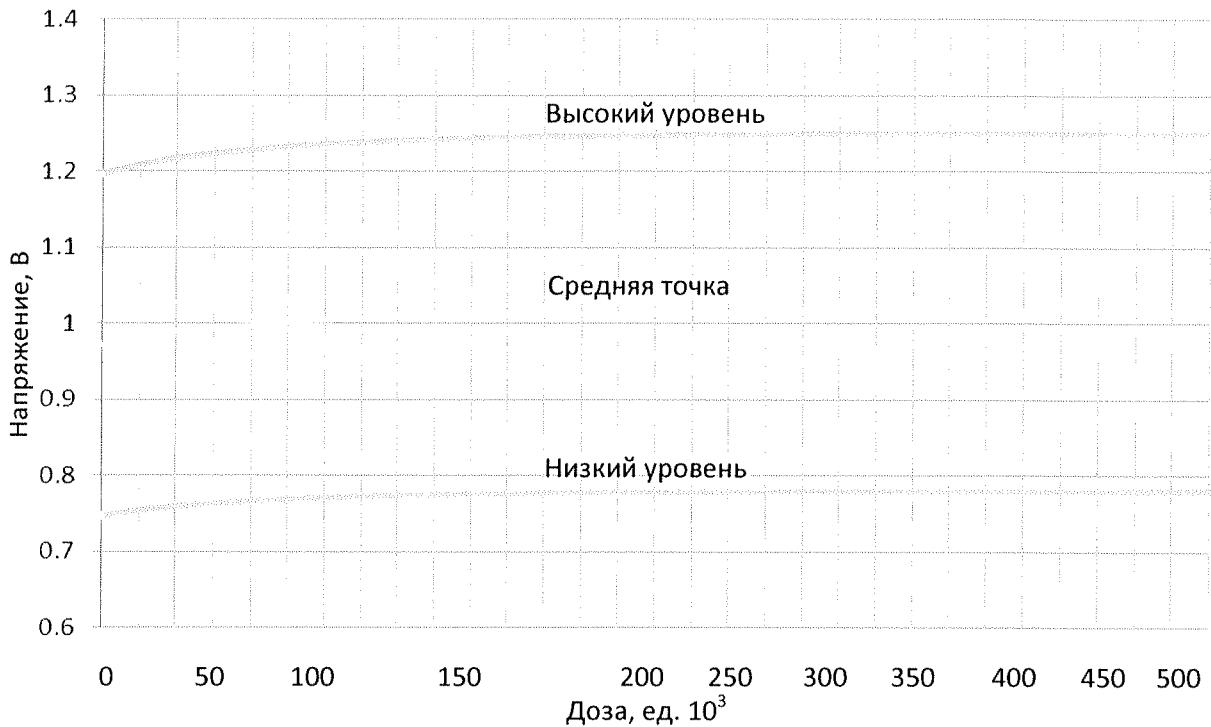


Рисунок 5 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1449	Экт 16.01.20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
13

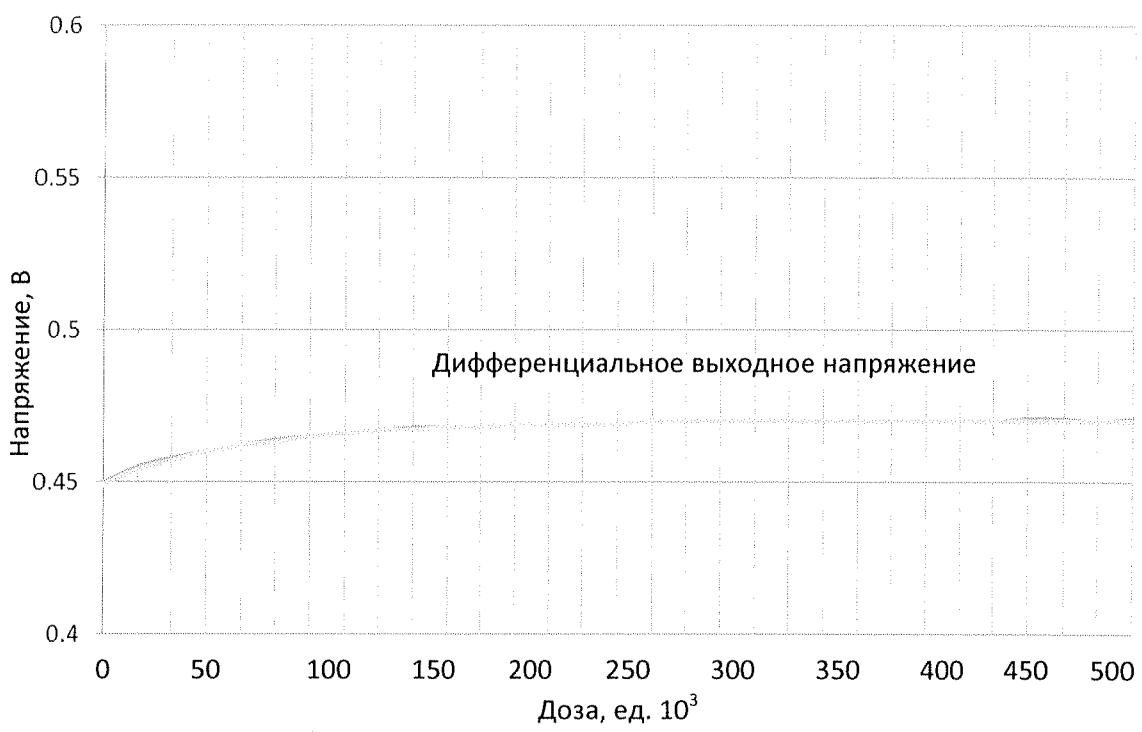


Рисунок 6 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17449	Документ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
14

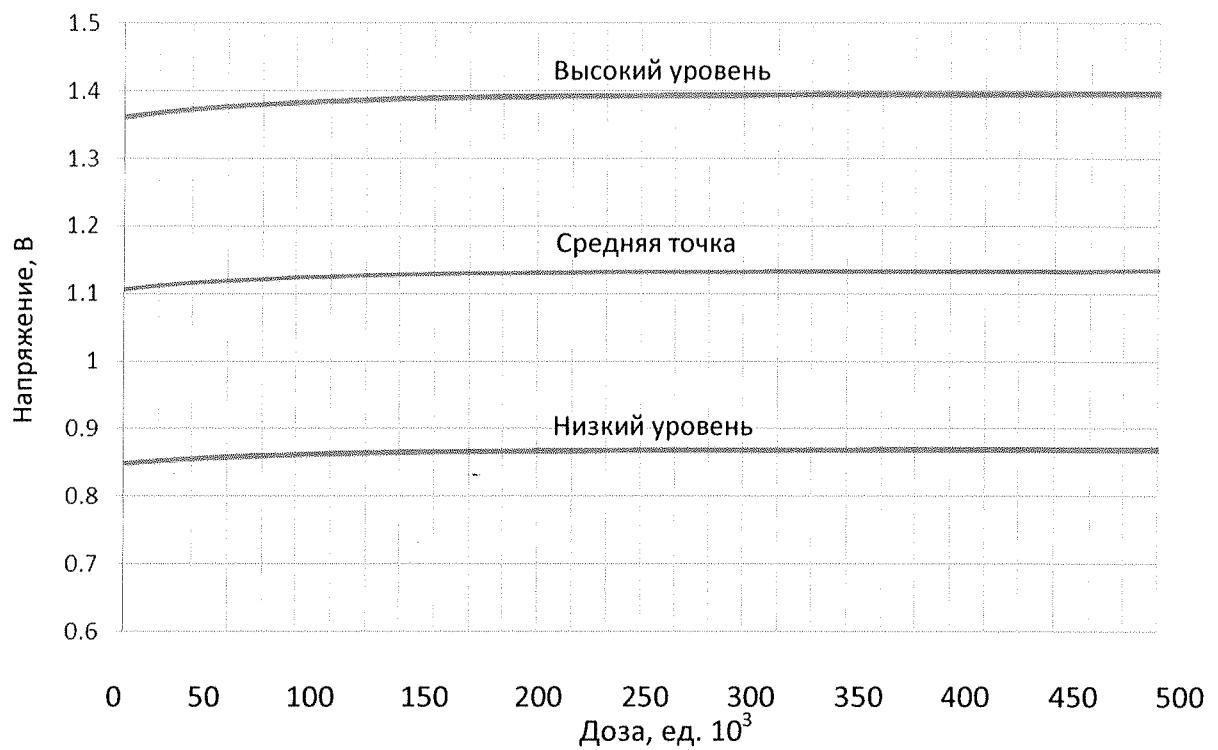


Рисунок 7 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,0$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.022Д1	16.01.07			

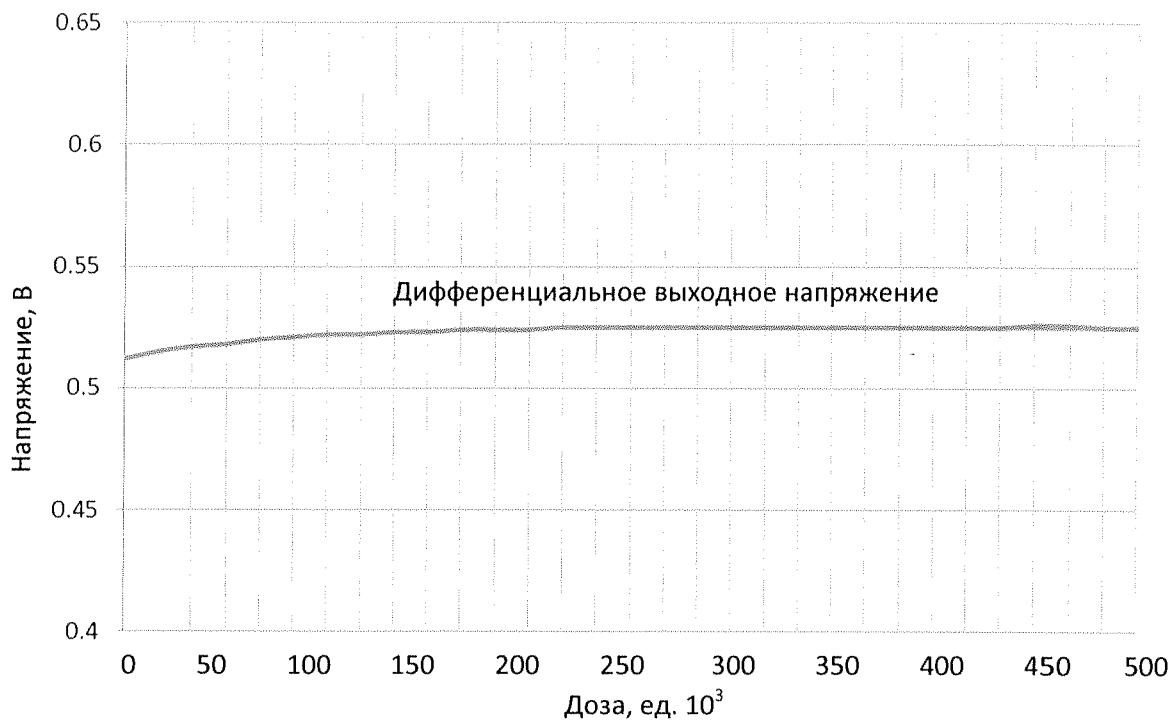


Рисунок 8 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,0$  В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
ГАВЛ.431268.022Д1	2016.01.10.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист

16

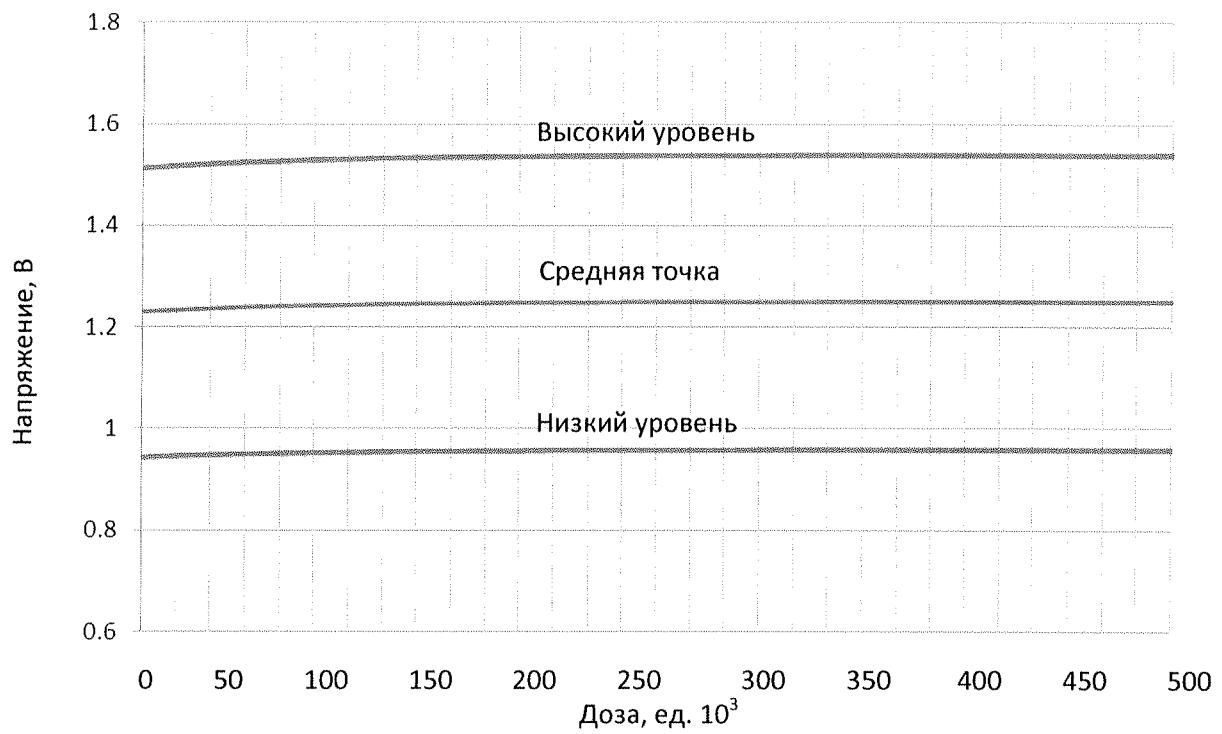


Рисунок 9 – Зависимости уровней выходного сигнала M–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.022Д1	2016.01.05			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						17

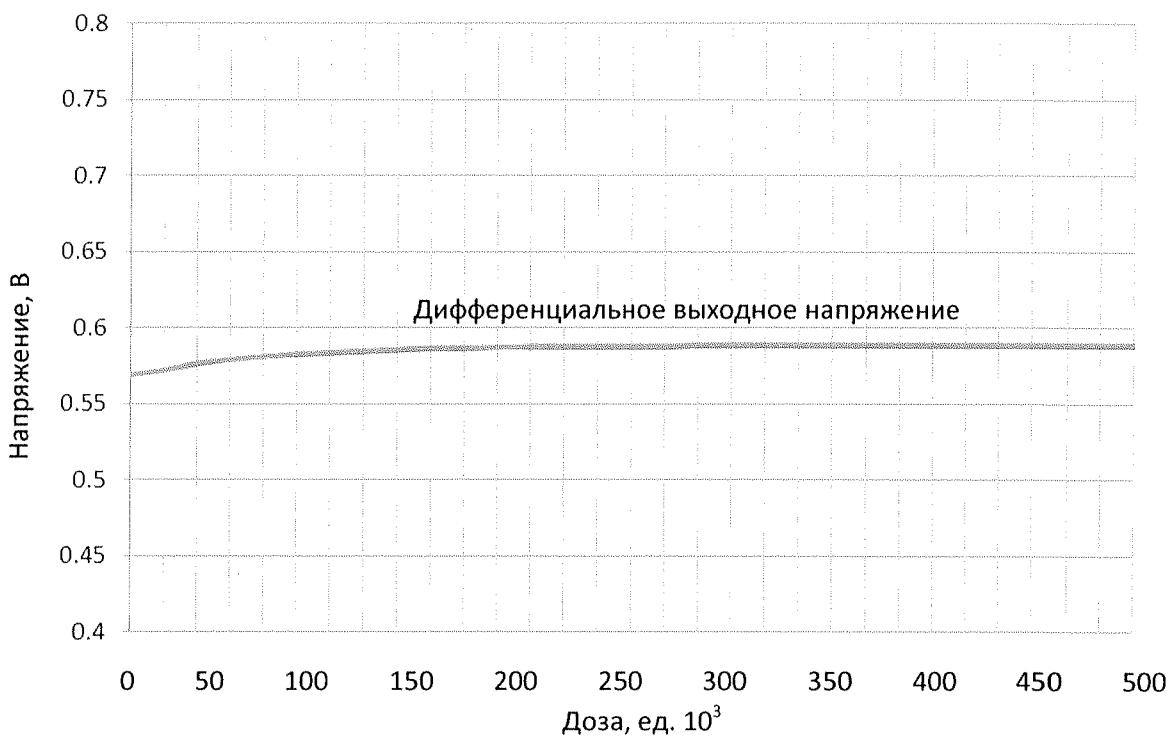


Рисунок 10 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1449	Лист 16.07.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.022Д1	Лист
						18

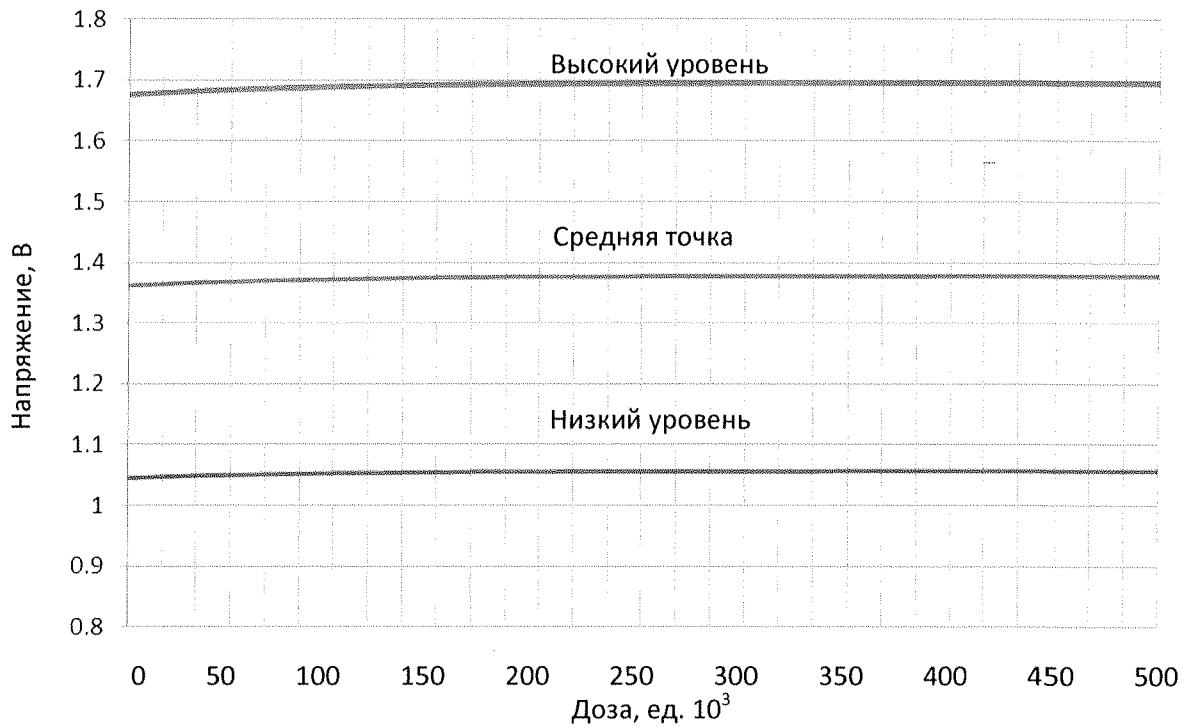


Рисунок 11 – Зависимости уровней выходного сигнала M–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 1	Лист № 01 из 02			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
19

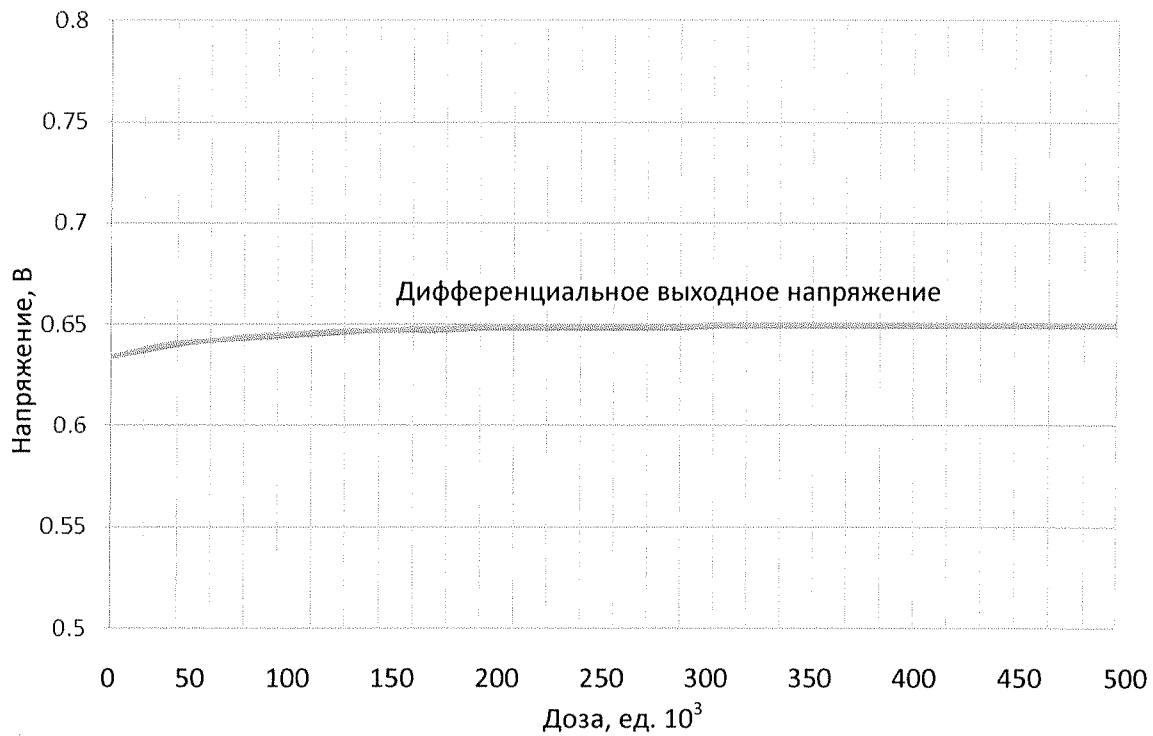


Рисунок 12 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1449	Дарья Ольга			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
20

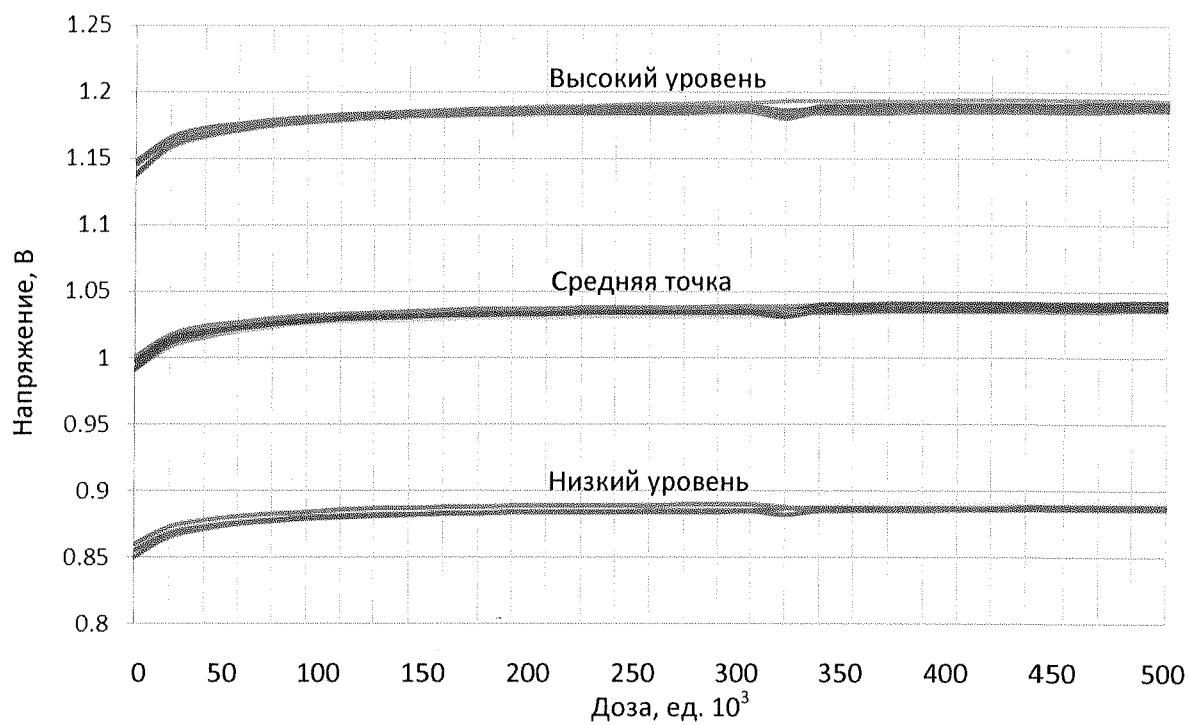


Рисунок 13 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1449	Дир. Н.С.Абз.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
21

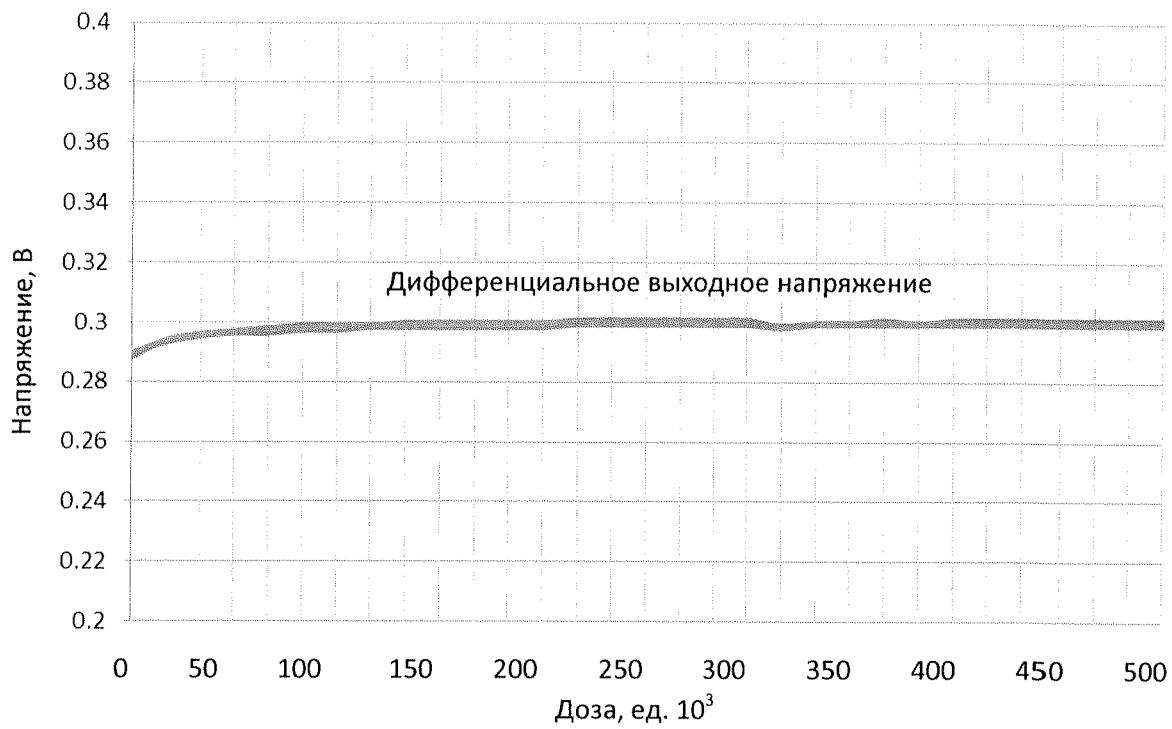


Рисунок 14 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14449	Дат 16.01.2009			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
22

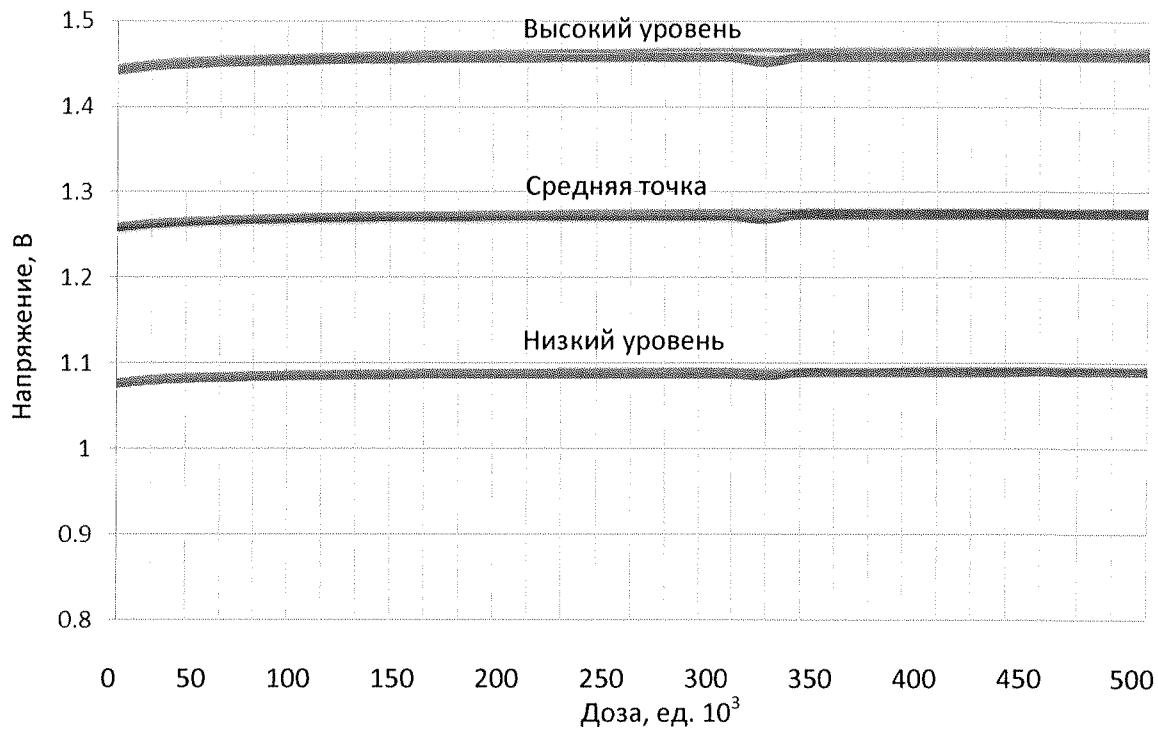


Рисунок 15 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. Лист	Лист 16 из 20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
23

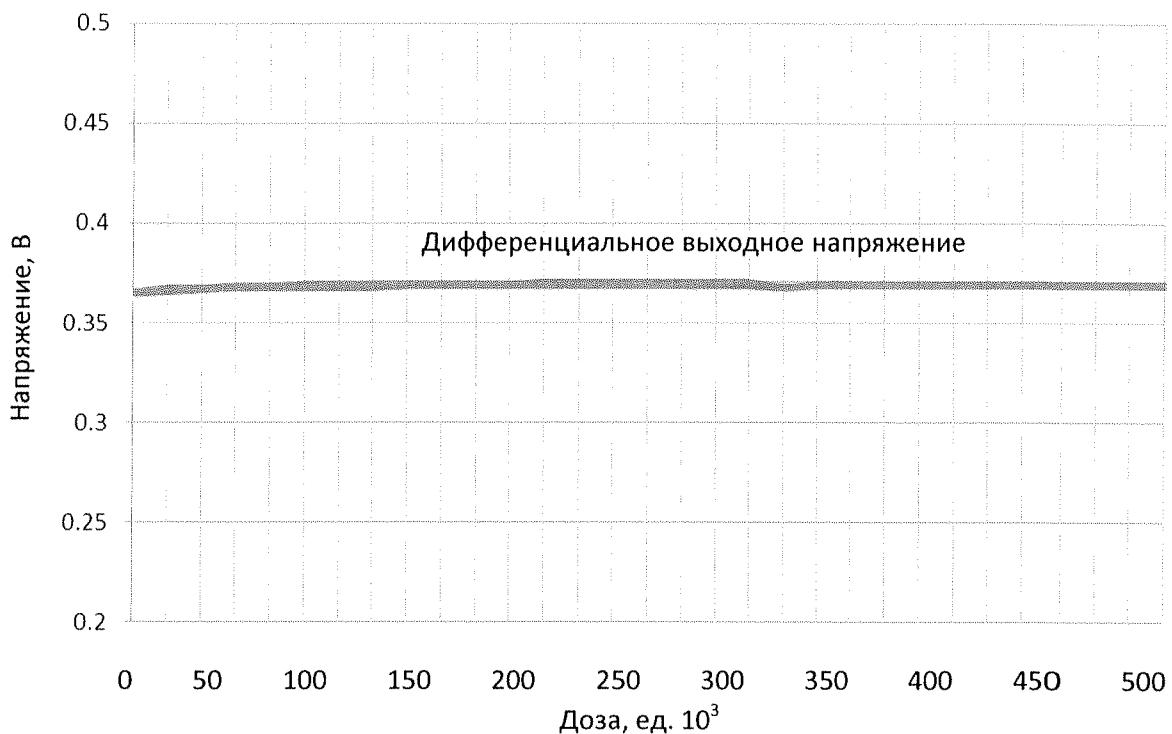


Рисунок 16 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
13.12	Лист № 01 из 03			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					ГАВЛ.431268.022Д1

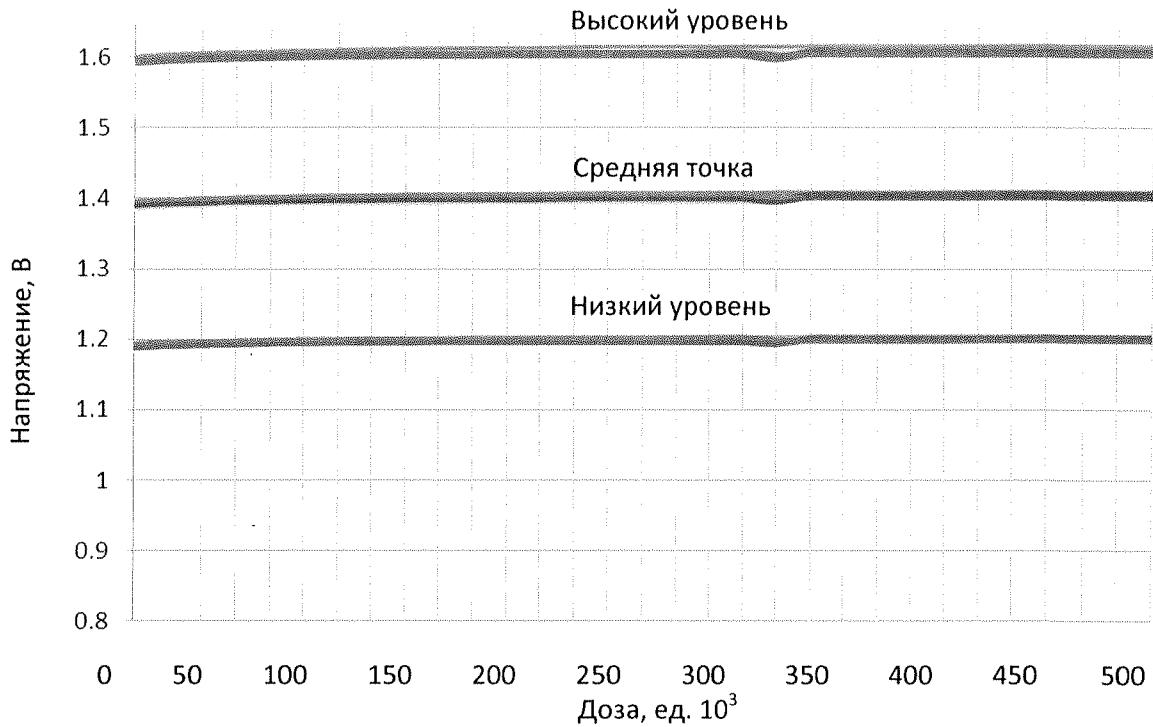


Рисунок 17 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 14449	Лит. 16.01.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
25

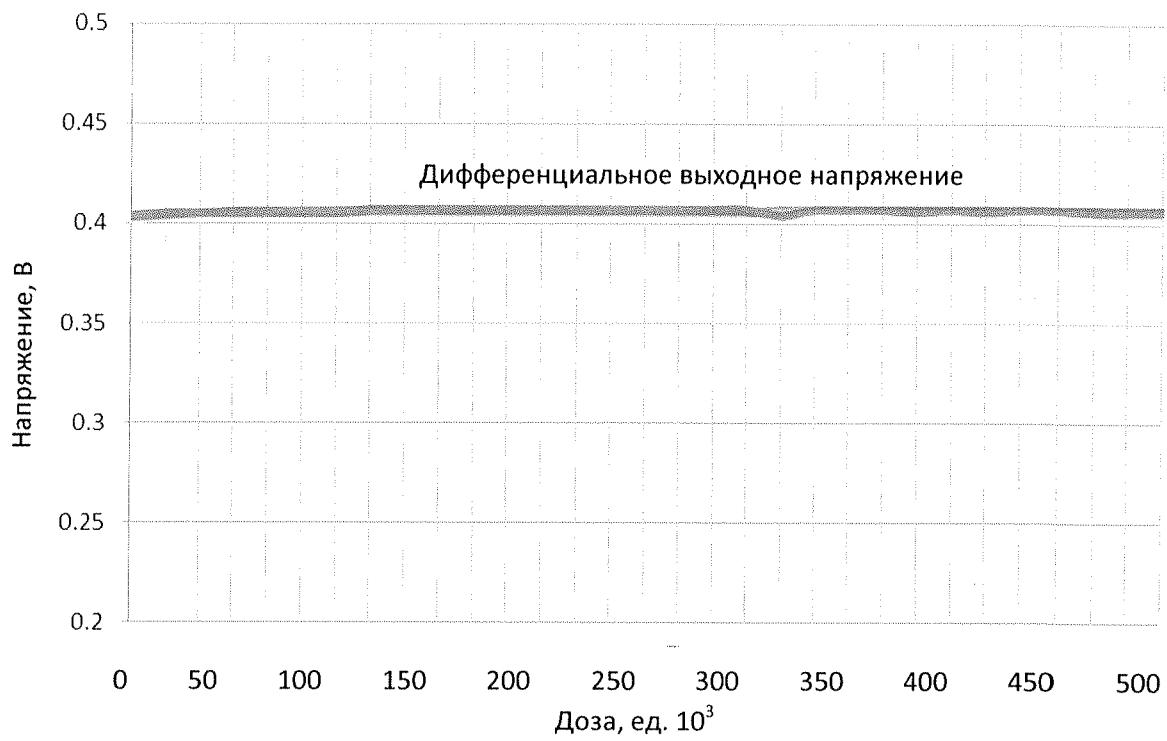


Рисунок 18 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1449	Дар Н.О. 20.07.2017			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.022Д1

Лист  
26

## Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв. № подл.	Подл. и дата
1449	20.01.2010

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**ГАВЛ.431268.022Д1**

Лист

27